第一图书网, tushu007.com

<<微光机电系统>>

图书基本信息

书名：<<微光机电系统>>

13位ISBN编号：9787111192664

10位ISBN编号：7111192664

出版时间：2006-8

出版时间：机械工业

作者：张文栋

页数：310

字数：390000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

本书介绍了微光机电系统（Nicro-Optical-Electro-mechical System,MOEMS）的国内外发展状况，微器件的结构设计与仿真，常用的微制造技术，如表面工艺、体硅工艺和LIGA工艺，封装技术等。
本书的重点是介绍各种MOEMS器件，包括微力学器件、RF微器微光学器件、微流体器件以及微温度传感器和微磁场传感器等。
介绍微器件时，本书从各器件的工作原理、工艺步骤、性能指标等入手，意在使读者更好地了解目前已经研制成功的各种微器件及微系统，并能在实际的工程中考虑使用。
　本书可作为从事MOEMS技术应用和开发的工程设计人员，科技管理人员以及相关专业研究生的参考书。

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

丛书序前言第1章 微光机电系统概述 1.1 微光机电系统的定义与历史 1.2 MOEMS的应用和市场前景 1.3 与MOEMS相关的资讯 参考文献第2章 MOEMS的设计与仿真 2.1 微型化带来的“特殊”理论问题 2.2 MOEMS的设计过程 2.3 MOEMS的仿真及其软件 2.4 MOEMS CAD软件 参考文献第3章 典型的微结构制造工艺 3.1 微电子工艺概述 3.2 表面工艺 3.3 体硅工艺 3.4 LIGA工艺 3.5 微制造工艺小结 参考文献第4章 MOEMS器件 4.1 MOEMS器件的敏感原理和执行方式 4.2 微力学器件 4.3 RF微器件 4.4 微光学器件 4.5 微流体器件 4.6 其他微传感器 参考文献第5章 微系统集成 5.1 微封装技术 5.2 微系统集成应用实例 参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com